

臺灣高等法院民事判決

110年度重上更一字第1號

上訴人 鈺緯科技開發股份有限公司

法定代理人 陳國森

訴訟代理人 李宗德律師

劉昱劭律師

複代理人 許芸瑋律師

被上訴人 友順科技股份有限公司

法定代理人 高耿輝

訴訟代理人 王怡惠律師

複代理人 江帝範律師

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國107年5月16日臺灣臺北地方法院105年度重訴字第689號第一審判決提起上訴，經最高法院發回更審，本院於110年12月15日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審及發回前第三審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：伊於民國102年10月15日向原審共同被告晶偉電子股份有限公司（下稱晶偉公司）購買被上訴人生產，批次QH TG（下稱系爭批次）、型號LD1117AL-1.2V-A-Q之穩壓晶片2,500個（下稱系爭晶片），於同年12月3日交貨，伊於103年2、3月間將之安裝於醫療等專業用途之顯示器，出售予訴外人臺灣三菱電機股份有限公司（下稱三菱公司）、日商JVC Kenwood Corporation（下稱JVC公司）、馬來西亞商Plexus Manufacturing SDNBHD（下合稱三菱等公司）。嗣三菱等公司自同年6月起陸續反應顯示器之螢幕（下稱系爭螢幕）出現電壓異常等

問題，伊乃轉知被上訴人，被上訴人檢測系爭晶片2個、2個、3個後，依序於同年7月18日、8月7日、9月29日出具客戶訴怨回答書（下稱系爭客訴回答書）予伊，確認系爭晶片有鋁墊與焊點焊球結合不完全之瑕疵（下稱系爭瑕疵），並於103年8月20日出具保證書（下稱系爭保證書）承諾賠償伊所受損害等情，爰依系爭保證書，求為命被上訴人賠償伊所受損害新臺幣11萬8,812元、美金7萬4,097.5元、日幣923萬8,821元及法定遲延利息等語。

二、被上訴人則以：上訴人係提出業已上錫使用之晶片供伊測試，伊出具之系爭客訴回答書並未表示全新未使用之系爭晶片有瑕疵；上訴人將系爭晶片焊錫加工在其設計之螢幕電路板（主機板）上，經其百分之百燒機測試後並無問題，足見系爭晶片本身並無瑕疵，系爭螢幕電壓異常可能係上訴人加工、運送、或三菱等公司使用不當等其他因素造成，上訴人不得請求伊賠償損害。況系爭批次之晶片縱有瑕疵，最多僅64個，並非2,500個全部均有瑕疵，且被上訴人提出如前審判決附表3「證據」欄所示之請求（折讓）單據、三菱公司聲明書，均未經JVC公司、三菱公司核章，不能據為其受損害之證明等語，資為抗辯。

三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴並減縮聲明，經本院前審改判命被上訴人應給付上訴人新臺幣11萬8,812元、美金7萬4,097.5元、日幣923萬8,821元，及自105年5月18日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並駁回上訴人其餘上訴。被上訴人就其敗訴部分提起上訴，經最高法院發回更審，上訴人上訴聲明：(一)原判決關於駁回上訴人後開第(二)項請求暨部分假執行聲請，並訴訟費用（除確定部分外）之裁判均廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人新臺幣11萬8,812元、美金7萬4,097.5元、日幣923萬8,821元，及自105年5月18日起至清償日止，按年息5%計算之利息。(三)願以現金或等值之銀行無記名可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利之判決，願供擔保請

01 准宣告免為假執行〔上訴人請求超過上開金額本息及請求晶偉
02 公司給付部分，本院前審維持第一審所為其敗訴之判決，其未
03 提起第三審上訴，該部分業已確定，均不予贅敘〕。

04 四上訴人主張伊於102年10月15日向晶偉公司購買被上訴人生產
05 之系爭晶片，於同年12月3日交貨。伊將系爭晶片焊錫加工在
06 其設計之螢幕電路板（主機板）上，經其百分之百燒機測試後
07 並無問題，其復於主機板上組裝多種電子零件，施以多重加工
08 後，將系爭螢幕出售予三菱等公司。三菱等公司自103年6月起
09 陸續向上訴人反應系爭晶片有電壓輸出不足之瑕疵，伊乃轉知
10 被上訴人，被上訴人依序受理伊退回之系爭晶片2個、2個、3
11 個，並於同年7月18日、8月7日、9月29日出具系爭客訴回答書
12 等情，為被上訴人所不爭執（見本院前審卷(一)第122頁），自
13 堪信為真實。

14 五上訴人主張被上訴人所生產之系爭晶片有系爭瑕疵，請求被上
15 訴人賠償其所受損害，然為被上訴人所否認，並以前開情詞置
16 辯。經查：

17 (一)按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，
18 此為民事訴訟法第277條本文所明定。上訴人主張系爭晶片
19 有瑕疵，既為被上訴人所否認，上訴人自應就其收受系爭晶
20 片，即已有其所指瑕疵之事實負舉證責任。

21 (二)上訴人主張系爭晶片存有瑕疵，固提出系爭客訴回答書及閎
22 康科技股份有限公司報告（下稱系爭閎康公司報告），及委
23 任私立淡江大學電機系教授江正雄閱讀系爭客訴回答書後提
24 出專家意見書為憑（見原審卷(一)第35至44、206至215、222
25 至230、191-1至210-1頁、本院前審卷(一)第139至144頁），
26 並舉江正雄證詞為據（見本院前審卷(二)第104至111頁）。經
27 審視上揭專家意見書雖記載：晶片打線時，焊球與鋁墊間共
28 金層生成異常，將使晶片在正常使用環境下快速劣化，顯現
29 出短路、斷路等異常情形。安裝有共金層生成異常晶片之終
30 端電子產品，在晶片共金層裂縫尚未擴大到相當程度或斷裂
31 前，無法從終端電子產品的電路測試或燒機等檢測中發現晶

片之瑕疵等語。惟按，當事人一造於訴訟外自行委託具有特別學識經驗之人，就其專業領域提供相關經驗法則之意見或說明，無涉親身見聞待證事實，與民事訴訟法所定之鑑定或人證，均屬有別，除經他造同意外，不得作為認定事實之證據（最高法院109年度台上字第2986號判決發回意旨參照）。上揭專家意見書係上訴人於訴訟外自行委託江正雄所撰寫，而被上訴人復表示不同意江正雄之前開意見書為證據（見本院卷第55頁），且江正雄於前審已陳稱：其因為沒有看到系爭晶片，未就系爭晶片做通電測試，亦未就系爭晶片的共金層與其他晶片做對比性測試，故僅就系爭客訴回答書提出意見等歷歷（見本院前審卷(二)第109頁以下），揆諸前開說明，該專家意見書及江正雄證詞自不得作為認定本件事實之證據，先予敘明。

(三)次查，被上訴人出具之系爭客訴回答書係針對客退品即上訴人使用過之系爭晶片為分析，分析結果系爭晶片均呈現電性異常，表面有燒燬現象，內部焊球與鋁墊未形成共金層，可推斷焊球在與鋁墊結合時，中間金屬化合物生成有異常，可確定系爭晶片批次為單一風險批次，並均記載「可能原因」為：(1)W/B152號機台生產期間有卡料並進行軌道清理的紀錄，產品卡料而未即時處理會導致晶片表面氧化或汙染；(2)產品卡料時，未將卡料品放入氮氣櫃保存，導致晶片表面氧化；(3)晶片鋁墊氧化或汙染會導致打線時鋁墊與焊球結合不良等語。而證人即被上訴人工程師王啟任於原審就此證稱：其工作內容為產品檢驗及客戶應用處理，其有參與系爭客訴回答書之製作，上訴人將上錫使用過的系爭晶片退回給被上訴人做檢測，檢測後認為晶片的輸出電壓偏低，分析此異常現象的原因可能係縫隙的問題。縫隙的產生有可能是上訴人在做加熱或IR時熱應力所造成，也可能是拆卸時施力不當，還可能有其他原因。系爭客訴回答書判定造成客退品之問題有三種可能的原因，主要是針對兩造可能的原因先做說明，其中一個可能原因即是熱應力。伊去反查生產紀錄，發現生

01 產時有卡料現象，所以記載在系爭客訴回答書上。系爭客訴
02 回答書是針對客退品問題點去做推測，並非指被上訴人生產
03 之系爭晶片有瑕疵等語（見原審卷(二)第48-1至50-1頁）。再
04 觀諸上訴人員工寄給被上訴人員工之電子郵件亦記載：「如
05 附件之IC1及IC2之分析報告（即系爭客訴回答書），UTC
06 （即被上訴人）並未明確交代root cause，只用推估及可能
07 等說明原因。為做慎重釐清，DIVA（即上訴人）委請第三方
08 協助分析……」等語明確（見原審卷(二)第71頁），足徵系爭
09 客訴回答書僅係表示系爭晶片客退可能有上述三種原因，並
10 非表示系爭晶片存有瑕疵。至系爭閎康公司報告雖記載上訴
11 人送驗之晶片存有一條貫穿晶片之明顯裂口（Gap），惟被
12 上訴人已否認送驗之晶片為系爭晶片，且閎康公司亦函覆：
13 前開報告僅就上訴人指定之IC故障位址作結構和元素之分析
14 研究，並未涉及IC失效的原因和責任歸屬鑑定。建議應傳喚
15 兩造擬定分析計畫，共同採樣，方足以為證。上訴人並未告
16 知晶片型號和生產批次等語，有該公司106年6月7日閎康字0
17 000000函在卷可佐（見原審卷(二)第28頁），故難憑認系爭閎
18 康公司報告檢測之晶片即為系爭晶片。上訴人執系爭客訴回
19 答書、系爭閎康公司報告，主張系爭晶片具有瑕疵云云，洵
20 非可採。

21 (四)上訴人復主張系爭晶片之瑕疵初無跡象，縫隙係隨時間經過
22 越來越大，最終導致晶片異常及螢幕故障，該瑕疵無法依通
23 常之燒機檢查方法發見之瑕疵一事，證人即上訴人研發硬體
24 經理盧俊宇亦於原審證稱：依據三菱公司的報告及系爭客訴
25 報告，都是指向生產製程中系爭晶片產生縫隙，縫隙會慢慢
26 越來越大，而不是即時發生等語（見原審卷(二)第2-1至5-1
27 頁）；惟證人王啟任於原審證稱：燒機可以讓晶片的縫隙問
28 題凸顯，但其沒有聽過縫隙會越來越大這個理論等語（見原
29 審卷(二)第48-1至50-1頁）。證人即上訴人營運長謝冠彰於原
30 審另證稱：上訴人發包給上旺科技公司將系爭晶片焊接在印
31 刷電路板上後，再壹台壹台檢測螢幕有無正常，每臺螢幕都

01 需經過4至24小時燒機檢測，至少也會燒機4小時，完成後品
02 管人員還要抽樣檢測，將螢幕送給三菱等公司時，他們也有
03 進料人員進行抽樣。三菱等公司自103年6月起方陸續反應螢
04 幕有異常及故障之情形等語（見原審卷(二)第9至10-1頁），
05 可見系爭晶片歷經焊錫於主機板上、主機板安裝於系爭螢幕
06 上等多次加工程序，經檢測無誤始出貨予三菱等公司，待三
07 菱等公司使用一段時間後方反應系爭螢幕有異常，則被上訴
08 人辯稱系爭晶片係因事後加工、運送、使用後始產生異常，
09 尚非無據。上訴人並未舉證證明系爭螢幕異常係因系爭晶片
10 瑕疵所致，則其主張系爭晶片之瑕疵初無跡象，縫隙係隨時
11 間經過越來越大，最終導致晶片異常及螢幕故障，該瑕疵無
12 法依通常之燒機檢查方法發見之瑕疵，因此其受領系爭晶片
13 無從即時發現系爭瑕疵云云，即乏所據。

14 (五)再者，關於可否在晶片庫存品及客退品、原始生產紀錄與生
15 產設備等相關物證均未留存下，單以系爭客訴回答書鑑定系
16 爭晶片是否具有瑕疵、瑕疵之情形及如何造成，本院依兩造
17 聲請分別詢問財團法人工業技術研究院（下稱工研院）及私
18 立東吳大學李相臣教授結果，工研院亦函覆略以：造成晶片
19 瑕疵之原因眾多，本院歉難單以系爭客訴回答書鑑定晶片瑕
20 疵相關事宜，有該院110年8月24日工研轉字第1100017005號
21 函附卷可參（見本院卷第135頁）。李相臣則回覆：鑑定晶
22 片（chip）有無瑕疵、瑕疵情形為何及如何造成瑕疵，因為
23 各家晶片製程方式及使用晶片方式均不同，需要實體晶片製
24 品（庫存品及客退品）相互鑑定，方可以客觀的立場解釋說
25 明晶片究竟有無瑕疵、瑕疵情形為何及如何造成瑕疵？如無
26 實體晶片製品（庫存品及客退品）僅有8D（Discipline）報
27 告，則可能需檢視8D報告內容而定，惠請貴院提供關於晶片
28 使用者（USER）的8D報告及生產者的8D報告，相互比對後，
29 或許可以客觀立場瞭解晶片。但是科學建議：實際情形應以
30 實體晶片製品及客退品之鑑定結果為準，因為各家晶片製程
31 方式及使用晶片方式均不同，如無實體晶製品（庫存品及客

01 退品)無法驗證8D報告內容等語，有民事陳報狀存卷可佐
02 (見本院卷第149至151頁)。被上訴人雖聲請李相臣再為鑑
03 定，然兩造既無法提出系爭晶片，本院認核無必要，附此敘
04 明。

05 (六)此外，上訴人復未能再舉證證明系爭晶片確具有瑕疵，則其
06 主張因系爭晶片瑕疵受有損害，爰依系爭保證書，請求被上
07 訴人賠償云云，委無足取。

08 六綜上所述，上訴人依系爭保證書之約定，請求被上訴人給付新
09 臺幣11萬8,812元、美金7萬4,097.5元、日幣923萬8,821元，
10 及自105年5月18日起起至清償日止，按年息5%計算之利息，為
11 無理由，應予駁回。從而，原審所為上訴人敗訴之判決，並無
12 不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，
13 應駁回其上訴。

14 七本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證
15 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐
16 一論列，附此敘明。

17 八據上論結，本件上訴為無理由，判決如主文。

18 中 華 民 國 111 年 1 月 19 日
19 民事第五庭

20 審判長法 官 賴劍毅

21 法 官 洪純莉

22 法 官 陳君鳳

23 正本係照原本作成。

24 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
25 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
26 (均須按他造當事人之人數附繕本)上訴時應提出委任律師或具
27 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資
28 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但
29 書或第2項所定關係之釋明文書影本。

30 中 華 民 國 111 年 1 月 20 日

